

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 15 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、广合科技 董事长肖红星 2、广合科技 董事、总经理曾红 3、广合科技 副总经理、董事会秘书曾杨清 4、财务总监贺剑青 5、独立董事陈丽梅
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、肖董事长，您好！首先恭贺贵公司在香港成功上市。想向您请教一个问题：公司 2025 年出资设立了九派宏涛新兴产业创业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙），基金重点布局 AI 智能工业设备、AI 基础软件、AI 行业应用、人形机器人及上游核心零部件等创投方向。请问该产业基金目前是否已启动对外投资？若已有实际投资落地，所投企业具体聚焦哪些细分赛道与业务方向？</p> <p>九派基金已经启动对外投资，目前已经投出三个项目，主要围绕 AI 产业软硬件进行投资。谢谢！</p>

2、曾总，您好。之前公司反馈，800G 光模块产品仍在送样测试阶段，请问一下 1.6T 光模块产品或者 3.2T 光模块产品是否已经启动和合作方规划预研？感谢您的回复。

公司有启动针对光模块 PCB 产品的预研。具体业务进展情况可持续关注公司定期报告相关内容，感谢您的关注。谢谢！

3、公司 2025 年 11 月完成 M9 级材料可靠性测试并承接有关订单，请问当前订单规模、交付进度情况如何？2026 年预计该系列订单占算力 PCB 业务比重多少？

公司有进行相关产品的研发和样品制作，暂无量产订单。具体业务进展情况可持续关注公司定期报告相关内容，感谢您的关注。谢谢！

4、研发方面，高速板、高多层板、散热板这些高端产品进展如何？

我们紧密跟随全球算力技术路线图，围绕新一代算力产品及工艺开展各项研发工作。具体业务进展情况可持续关注公司定期报告相关内容，感谢您的关注。谢谢！

5、董秘您好，PCIE 6.0 不仅是速率的提升，更是对板材和工艺的颠覆。在当前高端产能依然紧缺的背景下，广合科技的高端产能是否已经出现了‘供不应求’的迹象？这种‘卖方市场’的格局，是否意味着公司在三季度不仅能实现量的增长，更能实现‘量价齐升’，从而夯实当前的高估值？”

算力需求确实引发 PCB 高端产能紧缺的情况，伴随新产能的释放和产品迭代升级推动的产品单价稳步提升，业绩增长趋势将会延续。谢谢！

6、公司未来会优先扩产，还是稳定分红、考虑回购？

有利于公司发展一定是管理层决策考量的优先项，但公司决

策也会兼顾好股东的短期利益和长期利益。谢谢！

**7、除了服务器板，公司在汽车电子、AI PC、通信板上有没有重点布局？**

公司产品广泛应用于服务器、通讯、消费电子、工业控制、安防、汽车电子等领域，服务器应用是公司的核心业务。谢谢！

**8、行业并购整合增多，公司有没有并购优质标的、补齐技术或产能短板的计划？**

公司对并购持开放态度，目前没有相关并购信息。谢谢！

**9、各位领导好，2025年PCB行业周期波动明显，公司判断接下来行业景气度怎么走？**

2025年PCB行业总体呈现复苏的状态，不同细分应用领域存在结构性差异，算力应用市场总体表现强劲。在算力应用细分领域，2026年仍将延续2025年的趋势。谢谢！

**10、铜箔、树脂、玻璃布价格波动大，公司锁价、备库、降本机制是怎样的？**

铜箔、树脂、玻纤布是我们上游CCL厂商覆铜板的原材料，近半年来受上游供应紧缺、铜价大幅上涨、需求旺盛等因素共同影响，材料价格出现较大涨幅。公司与各供应商达成供货协议，优先保障供应、价格根据市场行情共同协商兼顾供需双方利益。应对原材料大幅上涨，公司也通过提升良率降低报废、优化订单结构、涨价等方式确保公司毛利率维持稳定。谢谢！

**11、行业竞争激烈、价格压力大，公司怎么维持毛利率稳定、避免恶性竞争？**

PCB行业是一个充分竞争的行业，赢得竞争不能依靠简单内卷价格，应当从关键技术能力提升、准时交付、产品品质、售后

响应及有效处置等多维度提升企业能力,以更高水平参与市场良性竞争。谢谢!

**12、公司现有产能利用率如何?未来一两年有没有扩产或新建高端产能计划?**

公司产能利用率一直处于接近满产状态,公司持续通过技术改造和新产能建设不断扩大产能,以满足下游客户对高性能 PCB 的需求。未来两年公司依然会根据客户的需求和自身产能情况进行扩产,具体扩产计划请关注公司公告内容。谢谢!

**13、2026 年广合科技的业绩指引?**

2026 年算力需求增长强劲,公司对业绩保持增长充满信心,具体业绩指引请关注后续定期报告业绩预告内容。谢谢!

**14、海外客户拓展情况如何?未来会不会加大海外建厂或海外客户占比?**

在全球服务器制造 TOP10 中,有 8 个已经是广合科技客户,未来我们将继续加大市场开拓,争取做到全覆盖,同时进一步提升份额占比。谢谢!

**15、客户结构上,服务器客户集中度高不高?有没有拓展其他领域大客户?**

公司客户结构及业务占比非常健康,具体可翻阅公司 2025 年年报相关章节内容查阅。公司业务重点在算力场景应用,在工业控制、消费电子等应用场景中公司也会积极把握市场机会。谢谢!

**16、财务总监,PCB 行业资本开支大、折旧压力重,公司现金流和资本开支怎么平衡?**

公司会综合客户订单需求、自身产能、资金情况推动固定资

产投资，确保财务健康稳健。谢谢！

17、1. 公司已覆盖全球前 10 大服务器厂商中的 8 家，2026 年新增头部客户认证进展如何？新客户订单何时转化为量产收入？ 2. 财报显示公司持续加码 PCIe7.0、224G/448G 高速产品等前沿技术研发，请问截至 2026 年一季度末，相关前沿技术的研发进度、客户送样与认证情况如何？预计何时能实现批量出货？

公司各项重点客户认证工作按计划推进顺利，新客户从认证到量产导入会有一个过程，具体情况请关注公司公告及定期报告相关披露信息。PCIe7.0 平台相关应用技术尚处预研阶段，预计三季度后 PCIe6.0 将正式进入量产。谢谢！

18、1. 公司算力 PCB 占比约 80%，2026Q1 高毛利 AI 服务器 PCB、OAM 板、高阶 HDI 的收入占比分别是多少？ 2. 2026Q1 公司信用减值损失 - 1314.07 万元、资产减值损失 - 1907.74 万元，合计计提减值超 3200 万元，而 2025 年同期两项减值合计为正收益 452.26 万元，请问本季度大额计提减值的具体原因是什么？

2026 年 Q1 公司 18 层以上及高阶 HDI 产品收入约占主营业务收入的 28%。2026Q1 信用减值损失主要系报告期内伴随营业收入大幅增长的同时，应收账款余额相应有所增加，从而导致计提坏账准备有所增加，属于正常经营情况。资产减值损失主要系计提存货跌价准备增加所致。谢谢！

19、1. 2026 年一季度在手订单金额、订单结构如何？长单 / 框架协议占比多少？订单能见度能到几个季度？ 2. 财报显示公司持续加码 PCIe7.0、224G/448G 高速产品等前沿技术研发，请问截至 2026 年一季度末，相关前沿技术的研发进度、客户送样与认证情况如何？预计何时能实现批量出货？

	<p>公司目前在手订单充裕，算力场景需求增长强劲，具体经营数据和业务进展情况可持续关注公司定期报告相关内容，感谢您的关注。谢谢！</p> <p><b>20、领导，您好！我来自四川大决策请问，新能源（光伏 / 储能 / 新能源车）铜排、铜箔订单与毛利率，头部客户占比？</b></p> <p>公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，公司印制电路板产品主要定位于中高端应用市场，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域。题述问题非公司业务范畴，公司不生产铜箔。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-05-15